

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

沪士电子股份有限公司
投资者活动记录表

编号：2025-0611-013

投资者关系 活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 电话会议 ☐ 其他：_____
活动参与人员	淡水泉、广发证券、申万宏源、东方财富、山西证券、毓盛资本、友邦保险、上海瀛赐私募基金、领峰投资、上海保银私募基金、个人投资者 (参会者已签署书面调研承诺函，在交流活动中，我公司严格遵守相关规定，保证信息披露真实、准确、及时、公平，没有发生未公开重大信息泄露等情况。下文会议纪要中的内容不代表公司对未来的盈利预测和业绩指引，请投资者注意投资风险并谨慎投资。)
时间	2025 年 6 月 11 日 10:30-12:00； 15:10-16:50
地点	公司会议室
形式	实地调研
公司接待 人员姓名	李明贵、钱元君、王术梅
投资者关系活动 主要内容介绍	1、发展历程和经营策略 简要介绍公司历史沿革、发展历程。公司 PCB 产品以通信通讯设备、数据中心基础设施、汽车电子为核心应用领域。公司始终坚持实施差异化产品竞争战略依靠技术、管理和服务的比较竞争优势，依托平衡的产品布局以及深耕多年的中高阶产品与量产技术，重点生产技术含量高、应用领域相对高端的差异化产品。公司差异化经营，将技术能力、制程能力、产能结构动态适配市场中长期的需求结构，坚持面向整体市场的主要头部客户群体开展业务。我们定期报告中披露的前五大客户，在 2024 年收入同比实现不错成长的同时，公司还是努力保持行业头部客户的均衡，公司向来注重中长期的可持续利益，而非仅仅局限于眼前的短期利益。公司深知只有着眼长远，保持客户均衡，才能在

	不断变化的市场环境中稳健发展，实现可持续增长。公司需要准确把握未来的产品与技术方向，在超高密度集成、超高速信号传输等方面持续加大技术和创新方面的资源投入，通过技术创新、均衡的多元化客户结构、供应链韧性及区域布局，在复杂的市场环境中保持韧性和竞争优势，在不确定中锚定确定性。 2、公司收入结构 2024 年应用于 AI 驱动的服务器、数据存储和高速网络基础设施等领域的企业通讯市场板实现营业收入约 100.93 亿元，其中 AI 服务器和 HPC 相关 PCB 产品约占 29.48%；高速网络的交换机及其配套路由相关 PCB 产品约占 38.56%；其余主要是通用服务器、无线基础设施这些。2024 年公司汽车板整体实现营业收入约 24.08 亿元，其中公司毫米波雷达、采用 HDI 的自动驾驶辅助以及智能座舱域控制器、埋陶瓷、厚铜、P²Pack 等新兴汽车板产品约占 37.68%。 3、800G 交换机市场情况。 AI 的快速发展驱动数据中心交换机市场的深刻变革。传统上，数据中心交换机支出主要用于连接通用服务器的前端网络，然而人工智能与高性能计算集群的连接需要一个数据中心规模的架构，即人工智能后端网络，同时前端网络也需要额外的容量来支持后端部署，目前来看 800G 交换机市场需求还是不错的。 4、泰国工厂 泰国生产基地目前已小规模量产。公司正在全员攻坚，以期尽快提升生产效率和稳定生产良率。公司已全面加速开启客户认证与产品导入工作，在逐步释放产能的同时，进一步验证中高端产品的生产能力，为逐步提高产品梯次打好基础，为未来的市场竞争做好准备。同时借助精细化成本管控手段，以有效控制初期成本；搭建全方位风险预警与应对机制以应对海外工厂建设运营风险，夯实实现经营性盈利目标的桩基。 5、资本开支及市场情况 AI 驱动的服务器、数据存储和高速网络基础设施需求增长以及新兴应用领域的拓展为行业带来发展机遇，市场上相关高阶产品的产能供应并不充裕，公司近两年已加大对关键制程和瓶颈制程的投资力度，预计 2025 年下半年产能将得到有效改善。公司近两年加快资本开支，现金流量也有相应的体现。2025
--	--

	年第一季度财报现金流量表中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金约 6.58 亿。 从中长期看，人工智能和网络基础设施的发展需要更复杂、更高性能、更高层和高密度互连（HDI）的PCB产品，以支持其复杂的计算和数据处理需求，为PCB市场带来新的增长机遇，同时也对PCB企业的技术能力和创新能力提出了更高的挑战。更多的同行也纷纷将资源向该领域倾斜，试图进入该领域并取得一定的市场份额，未来的竞争势必会加剧。公司需要准确把握战略节奏，适度加快投资的步伐，通过深入分析市场趋势和自身发展需求，合理配置资源，将更多的资金投入到具有潜力和创新的领域，不断进行技术升级和创新，开发更高密度的互连技术、更高速的传输性能等，提高产品的竞争力，并快速响应市场需求，从而抢占市场先机，筑牢并拓展“根据地”业务，实现可持续发展。 在汽车电子领域，汽车 PCB 市场处在中低端供给过剩、价格竞争、原材料价格波动、技术研发压力等复杂的环境中，呈现出规模增长、竞争加剧、需求结构变化、技术创新加速等特征。智能化成为市场重要趋势，车企加快推动智能化迭代升级，L2 级辅助驾驶逐步普及，城市导航辅助驾驶落地加速，并将智驾下放到更低价位车型。技术创新将持续引领汽车 PCB 市场发展，需求结构也将不断变化，随着市场竞争的加剧，行业内中低端供给过剩的产能或将经历清理和优化调整。公司密切关注市场需求变化，依托深耕多年的通讯设备、汽车电子领域底层技术积累和创新能力以及在客户端长期累积的安全、稳定、可靠的产品质量信誉，与客户在新能源车三电系统，自动驾驶辅助，智能座舱，车联网等方面深度合作，加快新技术的研发投入，开展关键技术的研发，深度参与客户前期设计及验证，紧跟汽车行业的发展趋势，提升技术能力和适用性，增强与客户在技术上的准确支持以及在业务上的长期合作，逐步调整优化产品和产能结构，以应对市场挑战。此外公司通过和产业链合作伙伴的深度合作，持续推进应用于 800V 高压架构的产品技术优化和转移，推动采用 P²Pack 技术的产品在纯电动汽车驱动系统等方面的商业化应用。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
附件清单	无